

Brüssel, den 11. September 2026
(OR. en)

12887/26

Interinstitutionelles Dossier:
2026/0139(COD)

COMPET 1037
IND 530
MI 854
RC 20
RECH 347
TELECOM 413
FIN 1229
CADREFIN 384
CODEC 1621

VERMERK

Absender:	Generalsekretariat des Rates
Empfänger:	Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Betr.:	Vorbereitung der Tagung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie, Forschung und Raumfahrt)) am 24. September 2026 Verordnung über ein europäisches Chip-Gesetz 2.0 – Orientierungsaussprache

Die Delegationen erhalten anbei einen Hintergrundvermerk des Vorsitzes mit dem Titel „Europäisches Chip-Gesetz 2.0: Wie kann die gesamte Halbleiter-Wertschöpfungskette in Europa am besten gestärkt werden?“ im Hinblick auf die Orientierungsaussprache auf der Tagung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) am 24. September 2026.

**Europäisches Chip-Gesetz 2.0:
Wie kann die gesamte Halbleiter-Wertschöpfungskette in Europa am besten gestärkt
werden?**

Hintergrundvermerk des Vorsitzes

Kontext

Im September 2023 nahm die Europäische Union als Reaktion auf strukturelle Ungleichgewichte beim weltweiten Angebot und bei der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern das europäische Chip-Gesetz an. Das war die erste koordinierte Reaktion der EU auf kritische Schwachstellen in der Halbleiter-Lieferkette, die zu öffentlichen und privaten Investitionen in Höhe von mehr als 53 Mrd. EUR in die Halbleiterfertigung führte und gleichzeitig erhebliche Infrastruktur-Outputs erbrachte, darunter fünf hochmoderne Pilotanlagen, die hochinnovative Technologieinfrastrukturen darstellen, und ein EU-weites Netz nationaler Kompetenzzentren.

Dennoch ist die EU in Schlüsselbereichen der Halbleiter-Wertschöpfungskette nach wie vor von Drittländern abhängig. Beispielsweise belief sich der Halbleiterverbrauch in der EU im Jahr 2025 auf 41,1 Mrd. EUR – 10,5 % der weltweiten Lieferungen –, doch der Großteil der Produktion liegt nach wie vor außerhalb Europas.¹ Die KI-Revolution hat zu einem exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach Halbleitern geführt, der zum Zeitpunkt der Annahme des ersten Chip-Gesetzes nicht vorhersehbar war.

Von verschiedenen Seiten wurden weitere Maßnahmen gefordert, um hier Abhilfe zu schaffen. Im Draghi-Bericht wurde empfohlen, die Investitionen in Halbleiter mit einer stärker zentralisierten EU-Strategie erheblich zu erhöhen, um die technologische Souveränität zu stärken und gleichzeitig strategische Abhängigkeiten zu verringern.² Im Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs vom Mai 2025 über das Chip-Gesetz wurden angesichts des aktuellen Stands im Chip-Sektor in der EU und des kurz- und langfristigen Bedarfs der EU-Industrie klare, terminierte und realistische Ziele empfohlen.³

¹ DI GIROLAMO, F. und KOTSEV, A., From dependency to resilience – JRC science for EU technological sovereignty, Europäische Kommission, Ispra, 2026, JRC147104.

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC147104>

² Draghi, M. (2024). [The future of European competitiveness – In-depth analysis and recommendations \(Part B\)](#).

³ Dok. ST 8385/25 Sonderbericht Nr. 12/2025 des Europäischen Rechnungshofs: Die Strategie der EU im Bereich Mikrochips – Akzeptable Fortschritte bei der Umsetzung, doch reicht das Chip-Gesetz höchstwahrscheinlich nicht aus, um das allzu ehrgeizige Ziel der digitalen Dekade zu verwirklichen

Das Europäische Chip-Gesetz 2.0 und das Paket zur technologischen Souveränität

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission am 3. Juni 2026 das europäische Chip-Gesetz 2.0 als Teil des umfassenderen Pakets zur technologischen Souveränität Europas vorgelegt. Der Vorschlag soll auf den Errungenschaften des ersten Chip-Gesetzes aufbauen und gleichzeitig verbleibende Schwachstellen in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette beseitigen. Dieses Bestreben ist Teil des umfassenderen Ziels, die technologische Souveränität Europas zu stärken. Halbleiter sind nicht nur Industriegüter, sondern eine Grundlagentechnologie, die die digitale Wirtschaft und den grünen Wandel stützt. Die Bedeutung der technologischen Souveränität Europas wurde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union 2025 hervorgehoben, in der sie betonte, wie wichtig sie für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und strategischen Autonomie in einer sich rasch wandelnden digitalen Welt ist.

Das Paket zur technologischen Souveränität Europas soll eine umfassende, vielschichtige Strategie sein, die vernetzte und sich gegenseitig verstärkende Initiativen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette von Halbleitern und Dateninfrastruktur bis hin zu Software, Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz umfasst. Dementsprechend steht das Chip-Gesetz 2.0 im Einklang mit dem EU-Rechtsakt über Cloud- und KI-Entwicklung, einem strategischen Fahrplan für Digitalisierung und KI im Energiebereich und einer Open-Source-Strategie der EU. Folglich zielt es darauf ab, ein Niveau der Chipproduktion in der EU zu erreichen, das die technologische Souveränität unterstützt.

Im Rahmen des Fahrplans „Ein Europa, ein Markt“ soll bis zum zweiten Quartal 2027 eine Einigung über das Chip-Gesetz 2.0 erzielt werden.

Europäisches Chip-Gesetz 2.0: Stärkung der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette in Europa

Aufbauend auf den im ersten Chip-Gesetz festgelegten Zielen bestehen die beiden übergeordneten Ziele des Vorschlags für das Chip-Gesetz 2.0 darin,

- die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Halbleiters zu steigern, um eine widerstandsfähige Wertschöpfungskette in der EU aufzubauen und so ihre technologische Souveränität zu verbessern;
- die Krisenvorsorge zu verbessern, um die Versorgungssicherheit der EU zu gewährleisten.

Der Vorschlag für das Chip-Gesetz 2.0 soll auf der Grundlage der ursprünglichen Verordnung aufbauen und darauf abzielen, die technologische Souveränität der EU zu stärken und eine sichere, widerstandsfähige Versorgung mit Chips in allen Schlüsselsektoren, von Forschung und Innovation bis hin zur Produktion, zu gewährleisten, einschließlich sowohl handelsüblicher als auch fortgeschrittener Chips – insbesondere KI-Chips.

Eine wichtige Änderung gegenüber dem ersten Chip-Gesetz, das überwiegend angebotsorientiert war, besteht darin, dass mit dem Chip-Gesetz 2.0 mehr Gewicht auf nachfrageseitige Maßnahmen gelegt werden soll, um die Markteinführung europäischer Technologien zu beschleunigen. Die Binnennachfrage wird von der Industrie als wesentliches Element für künftige Investitionen in die Chipproduktion in der EU angesehen.

Das Chip-Gesetz 2.0 gliedert sich ähnlich wie die ursprüngliche Verordnung in drei Säulen.

Säule I zielt darauf ab, die strukturellen Schwächen Europas bei der Konzeption, der Entwicklung, der Prototypentwicklung und der ersten industriellen Einführung von Halbleitern zu beheben, indem ein umfassendes Innovationsökosystem geschaffen wird, das den gesamten Weg von der Forschung bis zur kommerziellen Produktion unterstützen kann. Die Kommission schlug vor, die Initiative „Chips für Europa“ zu einer Initiative „Chips für Europa 2.0“ weiterzuentwickeln, um die Lücke zwischen der Forschungsexzellenz der EU und deren ersten Nutzung durch die Industrie zu schließen, z. B. durch innovationsfördernde Beschaffung, ein Nachfrageforum und Nachfragebeschleuniger sowie die Einführung des Konzepts der Großen Herausforderungen.

Säule II umfasst Maßnahmen zur Verringerung strategischer Schwachstellen durch die Förderung von Investitionen in Produktionskapazitäten, die Stärkung der Lieferketten und die Schaffung engerer Verbindungen zwischen den Herstellern von Halbleitern und nachgelagerten Wirtschaftszweigen. Unter den möglichen strategischen Projekten, die im Chip-Gesetz beschrieben werden, schlug die Kommission vor, der fortgeschrittenen Fertigung höchste Priorität einzuräumen, um die Herstellung von KI-Chips und anderen Halbleitern zu unterstützen. In dem Vorschlag wird dargelegt, dass strategische Investitionen in Halbleiter von einem Genehmigungsverfahren von höchstens zwölf Monaten profitieren sollten. Für risikoanfällige Sektoren wie die Automobilindustrie zielt das Chip-Gesetz 2.0 darauf ab, die Diversifizierung der Versorgungsquellen zu fördern.

Säule III zielt darauf ab, die Fähigkeit der Europäischen Union zu stärken, Störungen in den Halbleiter-Lieferketten in koordinierter Weise zu antizipieren, zu überwachen und darauf zu reagieren. Zusätzlich zu den bereits mit der ursprünglichen Verordnung eingeführten Überwachungs- und Risikominderungsmaßnahmen schlug die Kommission vor, eine Unternehmensplattform für die Halbleiterlieferkette (B2B) einzurichten. Die Plattform, die auf freiwilliger Teilnahme beruht, soll Unternehmen die Instrumente bereitstellen, die sie benötigen, um strukturelle wechselseitige Abhängigkeiten zu erkennen und unabhängig proaktiv Maßnahmen zur Risikominderung in der Lieferkette zu ergreifen.

Fragen für die Aussprache

1. Wie sollte das Europäische Chip-Gesetz 2.0 ein optimales Gleichgewicht zwischen technologischer Souveränität, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und internationaler Zusammenarbeit bei der Entwicklung seines Halbleiter-Ökosystems herstellen?
 2. In welchen Halbleitertechnologien oder Bereichen der Halbleiter-Wertschöpfungskette sollte Europa eine globale Führungsrolle anstreben, die Resilienz erhöhen und Schwachstellen in der Wertschöpfungskette verringern?
-